

证券代码：688785

证券简称：恒运昌

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

编号：2026-022

投资者关系活动类别	☒特定对象调研☐分析师会议 ☐媒体采访☐业绩说明会 ☐新闻发布会☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（券商策略会）
参与机构名称	泰康资产、开源证券、华西证券、信达澳亚基金、融通基金、建信养老、鲲鹏资本、深圳民森、红土创新、国任保险、泉果基金、恒邦兆丰、康曼德资本、国联安基金、善思投资、金鹰基金、创华投资
时间	2026. 10. 15 13:30—17:30 2026. 10. 20 10:30—11:30
地点	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区、券商策略会
公司接待人员姓名	董事长、总经理 乐卫平 董事会秘书 庄丽华 投资者关系专员 郝一骏
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司目前的业绩情况如何？ 回答：2026年半年度内，公司实现营业收入27,836.07万元，包括自研产品24,272.21万元，主要以拓荆科技、中微公司、微导纳米、北方华创等客户为主，同时，屹唐股份、菲沃泰等也在逐步导入放量。公司2026年前三季度的业绩情况请以届时披露的2026年第三季度报告为准。 2. 请介绍一下公司最新一代产品Cedar系列及其他新产品的研发进展 回答：Cedar系列将射频电源和匹配器整合为一体化平台，配备多个中心阻抗应用、可实现快速数据及大数据采集等功能，可支撑更先进制程。公司第四代等离子体射频电源系统Cedar系列截至2026半年度已有部分机型小批量试产；公司在研项目之一“Jade系列匹配器”截至2026半年度处于样机设计中。公司新增在研项目“AI Model-Based RF Impedance Matching System”截至2026半年度已完成模型开发并在持续完善中。 3. 请介绍一下目前的行业发展情况 回答：根据SEMI数据，2026年第二季度全球半导体设备出货金额同比增长23%，达到405.3亿美元，环比增长11%。其中，中国大陆半导体设备出货金额达119.1亿美元；根据SEMI预测，中国大陆、中国台湾和韩国预计将在2028年前继续保持设备支出前三名的地位。 4. 请介绍一下公司目前的研发进展 回答：公司一直以来高度重视研发工作，结合行业发展趋势和客户需求持续推进技术创新，不断加大研发投入。2026年半年度内，公司研发

	费用4,575.24万元，同比增长5.64%，占营业收入比例达16.44%；截至2026年半年度末，公司研发人员达164人（含2026年引进的海外研发人才1名），公司不断优化人才结构。2026年半年度内，公司新增一项产品化支撑技术“匹配器宽频扫频匹配技术”。公司不断通过内生研发优化现有产品并拓宽产品品类，不断完善研发管理机制和创新激励机制，优化研发环境；同时，密切追踪最新的技术及发展趋势，开展对先进技术、先进工艺的研究，为技术突破和产品升级提供重要的基础和保障。 5. 请介绍一下公司产品原材料的国产化情况 回答：尊敬的投资者，您好！公司自2021年开始，先后在上游采购中实现了真空电容、陶瓷电容、MCU以及SiC MOS、LDMOS、部分ADC和FPGA等元器件的国产化，确认上游元器件的全国产化方案并先后在多种定制产品中实现了国产化应用，持续推进元器件的全面国产化验证工作。在研发过程中公司结合技术参数、客户要求、物料来源等因素综合考量原材料的选型，通过有针对性的研发设计调整，不断提高产品的性能和品质。在采购过程中，公司积极推进国产化率的提升，注重使用本土元器件，以促进国产替代。 6. 请介绍一下公司目前的产能情况及产能未来布局？ 回答：公司2026半年度的产能利用率达到102.46%。公司通过多个措施提升产能：截至2026年7月底，子公司恒运昌真空技术（沈阳）有限公司已通过客户验厂，下半年将开始逐步释放产能，公司将持续助力其实现从试产到量产的转换；公司也在同时推进深圳产能建设，包括不断挖掘现有产能潜力、新增租赁场地以扩大产能建设。未来，公司将重点推进半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目的建设，这些都将有助于后续产能的释放，为公司产能持续提升奠定基础。 7. 请介绍一下公司募投项目的最新进展？ 回答：截至2026半年度报告披露日，沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目已通过客户验厂审核。营销及技术支持中心项目中的北京恒运昌已处于正式运营阶段，上海恒运昌、武汉恒运昌分别于2026年4月及7月注册成立。半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目、研发与前沿技术创新中心项目和营销及技术支持中心项目的合肥中心处于前期准备阶段。 8. 请介绍一下公司的战略规划及进展 回答：公司致力于发展成为围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案的平台型公司，为客户提供一站式的产品和服务。公司以客户为中心，密切关注客户需求，强化与客户设计研发的沟通合作，持续收集下游行业市场与技术动态信息；通过内生研发，持续优化现有产品，提升性能与质量，并拓宽产品品类；同时，公司将借助外部并购等战略举措，以进一步增强等离子体工艺核心零部件的供应能力。公司在现有基础上，在沈阳建设半导体射频电源系统产业化中心，在深圳增加租赁场地扩大产能，接下来公司还将在深圳扩建半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地，持续推进产能建设。公司通过成立北京恒运昌、武汉恒运昌、上海恒运昌组建营销及技术支持中心，加强对客户的技术支持与服务。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息

风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单(如有)	无